



联络人

投资人关系

+886 3397 5999 ext. 1204

ir@winfoundry.com

稳懋半导体公告 2021 年第二季自结财务报告

2021 年 7 月 29 日

稳懋半导体，全球最大砷化镓晶圆代工服务公司，已于今(29)日公告 2021 年第二季自结财务报告。

2021 年第二季财务概况

- ◆ 本季合并营收新台币 61.95 亿元，较前季增加 3%，较去年同期增加 2%
- ◆ 本季合并毛利率为 35.7%，较前季增加 2.2 个百分点；本季营业净利率为 22.7%，较前季增加 2.8 个百分点
- ◆ 本季营业净利为新台币 14.09 亿元，较前季增加 18%，较去年同期减少 31%
- ◆ 本季税后净利为新台币 9.3 亿元，较前季减少 15%，较去年同期减少 44%；每股盈余为新台币 2.32 元，前季为新台币 2.72 元

2021 年第三季展望

下列对于未来展望的表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。请参阅后附之「免责声明」。

- ◆ 第三季营收预计较前一季增加 high-single digit 百分比。
- ◆ 第三季毛利率预计约为 mid-thirties 的水平。

免责声明

本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外，公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。

管理者评论

“经历第一季的传统淡季之后，稳懋在客户需求逐步回升之下，2021年第2季营收为新台币61.95亿元，较上一季及去年同期分别成长3%及2%，表现大致符合之前预期。在产品组合变化的因素之下，第二季毛利率较上一季增加2.2个百分点，回升到35.7%，也使得营业净利率较上一季增加2.8个百分点，回到22.7%的水平。第二季EPS为新台币2.32元，上半年合计为新台币5.04元。

综观第二季各项产品组合表现，除了 *infrastructure* 营收维持第一季的水平外，*cellular PA* 营收成长双位数最为突出，其中 *5G PA* 出货占整体 *cellular PA* 营收比重再度回到20%以上，中国 *fabless* 客户动能明显提升也是成长的因素之一。去年第三季之后，尽管在中美贸易冲突中稳懋无法再继续供货给当时中国最大的客户，不过就如我们之前所预期的，在智能型手机终端市场的重新洗牌后，稳懋客户分散的策略再度奏效。多家与稳懋往来多年的中国客户纷纷把握机会取得市场占有率，在稳懋强大的研发及产能奥援之下选择与稳懋紧密合作，创造双赢，让我们对2021年营收持续成长充满信心。在因应客户未来的成长及产能的长期需求，稳懋将秉持一贯的策略，除了持续投入研发资源参与客户下一代的产品开发之外，并持续扩充产能，透过客户的市场占有率提升以壮大我们化合物半导体晶圆代工的龙头地位。

展望2021年第三季，我们预计营收将较上一季增加 *high-single digit* 百分比，预计毛利率约为 *mid-thirties* 的水平。”

关于稳懋半导体

稳懋半导体成立于1999年，位于林口华亚科技园区，是全球首座以六英寸晶圆生产砷化镓微波集成电路(GaAs MMIC)的专业晶圆代工服务公司。稳懋拥有完整的技术团队及最先进的砷化镓微波晶体管及集成电路制造技术及生产设备，客户群除了全球射频集成电路设计公司(RFIC Design Houses)外，并致力吸引与全球整合组件制造(IDM)大厂合作。在制程技术发展方面，稳懋以多元化及领先为原则，期能提供客户最完整的服务。在无线宽带通讯的微波高科技领域中，稳懋目前提供两大类砷化镓晶体管制程技术：异质界面双极性晶体管(HBT)和应变式异质界面高迁移率晶体管(pHEMT)，二者均为最尖端的制程技术。在光通讯及3D感测领域中，稳懋更以MMIC生产技术为基础，提供光电产品的开发与生产制造。